

招商证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为拓荆科技持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关规定，负责拓荆科技上市后的持续督导工作，持续督导期为 2022 年 4 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日。

2024 年上半年度，招商证券对拓荆科技的持续督导工作情况总结如下：

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与拓荆科技签订《保荐协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解拓荆科技业务情况，对拓荆科技开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024 年上半年度，拓荆科技在持续督导期间内未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。

序号	工作内容	持续督导情况
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。	2024 年上半年度,拓荆科技在持续督导期间内未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	2024 年上半年度,保荐机构督导拓荆科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促拓荆科技依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对拓荆科技的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,截至本持续督导跟踪报告出具之日,拓荆科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促拓荆科技严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对拓荆科技的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024 年上半年度，拓荆科技无控股股东及实际控制人，拓荆科技第一大股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，拓荆科技无控股股东及实际控制人，拓荆科技及其第一大股东、董事、监事、高级管理人员等不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2024 年上半年度，拓荆科技未发生前述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。 上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。 本持续督导期间，拓荆科技不存在前述需要进行专项现场检查的相关情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2024 年上半年度，保荐机构和保荐代表人未发现拓荆科技存在重大问题。

三、重大风险事项

公司面临的主要重大风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

随着半导体行业技术的发展和迭代，下游客户对半导体设备性能的要求也随之提升。因此，公司需要持续保持较高的研发投入，保持产品的核心竞争力和先进水平。如果公司未来未能跟进下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，或者技术创新产品不能契合客户需求，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

公司建立了科学的研发体系，技术创新紧跟市场需求，研发立项以客户需求为导向，始终与客户保持持续有效沟通，以避免可能的技术研发失败给公司带来损失。

（二）经营风险

1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所沉积的薄膜技术参数直接影响芯片性能。生产中不仅需要在成膜后检测薄膜厚度、均匀性、光学系数、机械应力及颗粒度等性能指标，还需要在完成晶圆生产流程及芯片封装后，对最终芯片产品进行可靠性和生命周期测试，以衡量薄膜沉积设备是否最终满足技术标准。因此，晶圆厂对薄膜沉积设备所需要的验证时间较长。同时，由于公司开发并推出更多新产品、新工艺，这些新产品和新工艺的验收周期相较成熟产品略长，导致公司的收入确认和回款将有所延迟，增加公司的资金压力，影响公司的财务状况。

随着公司产品在集成电路制造产线的应用规模逐步扩大，公司新平台、新工艺产品技术日益成熟，以及公司与客户高效稳定的合作下，产品的验证周期将呈缩短趋势。公司将持续关注公司的产品验证和回款情况，保证公司经营持续健康发展。

2、市场竞争风险

目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，与中国大陆半导体专用设备企业相比，国际巨头企业拥有客户端先发优势，公司的综合竞争力处于弱势地位，市场占有率较低。另外，国内半导体设备厂商也进入公司业务领域开发部分同类产品。公司面临国际巨头以及潜在国内新进入者的双重竞争。如果公司无法有效应对市场竞争环境，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等均会受到不利影响。

公司将持续关注国外竞争对手的发展，通过持续有效的研发投入不断缩短与国外厂商的技术代差，同时公司也密切关注国内竞争格局，不断扩大公司产品覆盖面，提升产品核心竞争力；公司亦将时刻关注行业竞争态势，科学合理的设定研发方向，加快研发进度，构筑较高的行业进入壁垒；同时，公司也将与客户保持更加紧密的合作，实现与下游客户的共同成长。

3、晶圆厂扩产不及预期的风险

下游晶圆厂产能规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

公司将随时关注半导体行业周期的发展阶段，根据市场情况统筹公司购、产、销各个环节，保持公司的经营活动与行业周期的协调；同时，公司将积极拓展客户群体，实现客户结构的多元化，避免因个别客户扩产不及预期造成重大不利影响。

4、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司的部分零部件暂时仍然需要向国外供应商采购。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司零部件的供应，可能会影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

公司与供应商积极开展更深入、更广泛的合作，采取全球化、多货源的供应策略，构建稳定的合作渠道，以加强自身供应链安全，降低国际产业链不稳定所带来的风险。

（三）财务风险

1、政府补助政策变动风险

公司在报告期内收到的政府补助主要是对公司研发投入的支持。如果公司未来不能持续获得政府补助，或政府补助显著降低，公司将需要投入更多自筹资金用于研发，进而影响公司现金流。此外，政府补助的减少，也会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

公司将持续扩大经营业务规模，提高盈利能力，以逐渐降低政府补助对公司经营业绩的影响。

2、税收优惠风险

报告期内，公司享受国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

随着公司盈利能力不断增强，市场占有率扩大及产品竞争力的持续提高，税收优惠政策波动对公司经营业绩带来的影响正逐步降低。

（四）行业风险

半导体行业受半导体技术迭代、终端消费市场需求影响，呈现周期性波动。如果下游终端市场需求或发展不及预期、终端消费供需结构变化较大时，下游晶圆厂会调整其资本性支出规模和设备采购量，从而对公司经营情况产生影响。

公司将随时关注行业动态及景气度波动情况，提前预判并统筹公司的经营活动，合理控制现金流，避免行业波动造成重大不利影响。

（五）宏观环境风险

半导体设备行业易受全球经济形势波动影响，如果未来宏观经济发展乏力，将影响半导体设备的市场需求量，从而对半导体设备行业的发展带来波动风险。

全球半导体产业已形成高度垄断格局，近年来，存在部分国家在强项领域设置贸易壁垒。如果国际形势进一步恶化，贸易摩擦进一步加剧，可能会对我国半

导体产业的发展带来不利影响。公司始终严格遵守各国法律，并持续关注国际贸易形势和行业发展趋势变化，提前制定防范措施。

四、重大违规事项

2024 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024 年上半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

（一）主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	2024 年 1-6 月比上年同期增减(%)
营业收入	1,266,890,685.67	1,003,709,264.02	26.22
归属于上市公司股东的净利润	129,093,960.35	124,565,953.33	3.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,957,472.69	65,182,519.13	-69.38
经营活动产生的现金流量净额	-899,812,522.62	-742,829,155.50	
主要会计数据	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,560,920,520.60	4,593,860,407.52	-0.72
总资产	12,473,072,407.66	9,969,345,254.15	25.11

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	2024 年 1-6 月比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	0.46	0.45	2.22
稀释每股收益（元 / 股）	0.46	0.45	2.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.24	-70.83

加权平均净资产收益率（%）	2.77	3.26	减少 0.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.43	1.71	减少 1.28 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	24.81	20.93	增加 3.88 个百分点

（三）变动合理性分析

2024 年 1-6 月，受益于公司持续高强度的研发投入，在推进产品产业化和各产品系列迭代升级的过程中取得了重要成果，超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PE-ALD SiN 工艺设备、HDPCVD FSG、HDPCVD STI 工艺设备等新产品及新工艺经下游用户验证导入，公司收入稳步增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 126,689.07 万元，同比增长 26.22%；出货金额 32.49 亿元，同比增长 146.50%。截至 2024 年 6 月末，公司发出商品余额 31.62 亿元，较 2023 年末发出商品余额 19.34 亿元增长 63.50%，为后续的收入增长奠定良好基础。随着公司产品布局逐渐完善，客户认可度持续攀升，出货机台陆续实现收入转化，2024 年第二季度营业收入达到 79,510.10 万元，同比增长 32.22%，环比增长 68.53%。

2024 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,909.40 万元，同比增长 3.64%，低于营业收入的同比增速，主要原因为：1）公司持续进行高强度研发投入，不断拓展新产品及新工艺，包括超高深宽比沟槽填充 CVD 设备、PECVD Bianca 工艺设备及键合套准精度量测产品，并持续进行设备平台及反应腔的优化升级，包括新型设备平台（PF-300T Plus 和 PF-300M）和新型反应腔（pX 和 Supra-D）等，同时进一步扩大公司产品及工艺覆盖面，提升产品核心竞争力，2024 年 1-6 月研发费用达 31,431.34 万元，同比增长 49.61%；2）为支持业务规模的高速增长及快速响应客户的需求，2024 年上半年销售人员薪酬等费用有所增加，销售费用达 15,979.17 万元，同比增长 39.24%。2024 年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,862.23 万元，同比增长 67.43%，环比增长 1,032.79%。

2024 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,995.75 万元，同比减少 4,522.50 万元，主要原因为 2024 年 1-6 月公司计入非经常性损益的政府补助收益为 10,712.91 万元，同比增加 4,790.86 万元。2024

年第二季度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,416.67 万元，同比增长 40.90%，环比大幅扭亏。

2024 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-89,981.25 万元，同比减少 15,698.34 万元，主要系：1) 出货金额及发出商品余额均大幅度增长带来的材料付款增加，本期购买商品、接受劳务支付的现金为 238,609.11 万元，较上年同期增加 62,277.78 万元，同比增长 35.32%；2) 预收货款对应的合同负债期末达到 203,760.70 万元，较 2023 年末增加 65,608.24 万元，增长 47.49%，本期销售商品、提供劳务收到的现金为 190,798.68 万元，较上年同期增加 57,313.64 万元，同比增长 42.94%。公司 2024 年第二季度经营活动产生的现金流量净额为-17,846.17 万元，较第一季度的现金流量净额-72,135.08 万元大幅度收窄，主要为第二季度销售商品、提供劳务收到的现金达到 140,783.46 万元，较第一季度增加 90,768.24 万元，环比增长 181.48%。

六、核心竞争力的变化情况

公司致力于研发和生产世界领先的高端半导体专用设备，始终坚持自主创新，持续为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司建立了创新管理体制，形成了多项国际先进的核心技术，并在研发团队、技术积累和研发平台、市场拓展和售后服务等方面形成竞争优势，具体体现为：

（一）具有丰富的技术储备及国际先进的核心技术优势

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得了多项自主知识产权。截至 2024 年 6 月末，公司累计申请专利 1279 项（含 PCT），获得授权专利 402 项，其中发明专利 209 项。

公司研发并推出的支持不同工艺型号的 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及超高深宽比沟槽填充 CVD 薄膜系列设备均已在客户端实现量产，在半导体薄膜沉积设备领域积累了多项研发及产业化的核心技术，构建了具有设备种类、工艺型号外延开发能力的研发平台，性能达到了国际同类设备水平。

公司面向国内半导体制造产业的实际需求和产线演进节奏，研制并推出了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备。公司未来将保持高强度的研发投入，

持续迭代升级、优化现有设备和工艺，不断推出面向未来发展需求的新设备、新工艺。

（二）优秀的技术研发及管理团队优势

公司已经建成了一支国际化、专业化的高端半导体专用设备技术研发及管理团队。公司立足核心技术研发，积极引进资深专业人才、自主培养科研团队。

公司国际化专业化的高级管理团队、员工的股权激励机制及具有竞争力的薪酬福利，吸引了大量具有丰富经验的国内外半导体设备行业人才加入公司，在整机设计、工艺开发、软件设计等方面做出突出贡献。公司自设立以来，自主培养本土科研团队，随着多项产品的研发成功，公司本土科研团队已成长为公司技术研发的中坚力量。截至 2024 年 6 月末，公司研发人员共有 506 名，占公司员工总数的 40.38%，研发人员中博士研究生 34 人，占比约 6.72%，硕士研究生 281 人，占比约 55.53%。公司的研发技术团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是奠定公司技术实力的基石，保障了公司产品的市场竞争力。2024 年 1-6 月，公司核心技术团队稳定，不存在重大不利变化。

（三）领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司以“建立世界领先的薄膜设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备这一半导体核心设备细分领域的技术积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。

公司已与国内半导体行业企业形成了较为稳定的合作关系。公司 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 及超高深宽比沟槽填充 CVD 等产品已批量发往国内集成电路晶圆厂产线。此外，公司正在积极拓展海外市场。

（四）稳定的供应链及较低的运营成本优势

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球范围内的供应链资源，与关键供应商建立战略合作关系，搭建了稳定的供应链结构。通过对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力。公司与供应商实时互动，协同产品创新，保持良好稳定的合作关系。

公司的主要竞争对手均位于国外，服务中国大陆客户的成本较高。公司的研发和生产主要位于中国大陆，拥有区位优势。在产品的设计方面，公司通过与供应商密切合作，使产品具有模块化、易维护的特点，从而降低公司原材料采购成本。随着上游供应商的快速发展，给予了公司更多的采购选择。因此，公司相比其主要竞争对手在运营成本方面具有一定优势，随着产能的不断提升，降本优势将更加明显。

（五）提供定制化产品及高效的售后服务优势

公司针对客户提出的特定工艺材料、特定制造工序薄膜性能的快速响应能力可以及时满足客户产线的定制化设备需求，这对下游晶圆制造厂能够快速扩充产能极其重要，由此建立和巩固与客户稳定的合作关系。公司主要客户的生产基地位于中国大陆，相较于国际竞争对手，公司管理和技术团队更贴近主要客户，能够提供高效的技术支持和售后服务，及时保障和满足客户需求。

2024 年上半年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2024 年 1-6 月，公司研发支出情况如下：

单位：元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	314,313,424.99	210,085,534.71	49.61
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	314,313,424.99	210,085,534.71	49.61
研发投入总额占营业收入比例（%）	24.81	20.93	增加 3.88 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备和混合键合设备的研发与产业化。截至 2024 年 6 月末，公司已先后累计承担 9 项国家重大专项/课题。

公司拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2024 年 6 月末，公司累计申请专利 1279 项（含 PCT）、获得专利 402 项；2024 年 1-6 月，公司新增申请专利 74 项（含 PCT）、新增获得专利 45 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,161.98 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 71.88 元，共募集资金人民币 227,283.12 万元，扣除发行费用 14,523.40 万元（不含税），募集资金净额为人民币 212,759.73 万元。前述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2022]139 号）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 67,499.45 万元，募集资金具体使用与结存情况如下表：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	212,759.73	
2024 年 1-6 月 发生额	项目投入	B1	24,725.53
	用于股份回购金额	B2	19,727.29
	利息收入净额	B3	924.90
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	B4	5,332.54
	项目投入	C1	117,094.29
	用于股份回购金额	C2	19,727.29

项目		序号	金额
截至 2024 年 6 月 30 日累计发生额	利息收入净额	C3	6,366.57
	完结项目剩余资金永久补充流动资金	C4	8,802.56
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额		D=A-C1-C2+C3-C4	73,502.16
减：理财产品余额		E	6,000.00
减：回购专用证券账户余额		F	2.71
期末募集资金账户余额		G=D-E-F	67,499.45

2024 年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，拓荆科技无控股股东和实际控制人，公司第一大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司 55,026,693 股股份，持股比例为 19.77%。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司部分董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份，具体情况如下：

姓名	公司职务	2023 年 12 月 31 日直接持股数量（股）	2024 年 6 月 30 日直接持股数量（股）	2024 年 1-6 月股份增减变动量（股）	增减变动原因
吕光泉	董事长、核心技术人员	740,000	1,095,200	355,200	公司 2023 年年度资本公积转增股本
姜谦	董事（2024 年 1 月离任）、核心技术人员	1,826,749	2,703,588	876,839	公司 2023 年年度资本公积转增股本
刘静	董事（2024 年 1 月任职）、总经理	40,700	60,236	19,536	公司 2023 年年度资本公积转增股本

姓名	公司职务	2023年12月31日直接持股数量(股)	2024年6月30日直接持股数量(股)	2024年1-6月股份增减变动量(股)	增减变动原因
曲晓军	职工代表监事(2024年1月任职)	19,240	-	-19,240	在担任职工代表监事之前个人减持
孙丽杰	副总经理(2024年1月离任)	31,450	46,546	15,096	公司2023年年度资本公积转增股本
陈新益	副总经理、核心技术人员	14,800	21,904	7,104	公司2023年年度资本公积转增股本
宁建平	副总经理、核心技术人员	14,800	21,904	7,104	公司2023年年度资本公积转增股本
牛新平	副总经理(2024年1月任职)	11,100	16,428	5,328	公司2023年年度资本公积转增股本
许龙旭	副总经理(2024年1月任职)	13,320	19,714	6,394	公司2023年年度资本公积转增股本
赵曦	副总经理(2024年1月任职)、董事会秘书	24,050	35,594	11,544	公司2023年年度资本公积转增股本
杨小强	财务负责人	4,440	6,571	2,131	公司2023年年度资本公积转增股本

截至2024年6月30日,公司董事(2024年1月离任)、核心技术人员姜谦及其一致行动人吕光泉、刘忆军、凌复华、吴飏、周仁、张先智、张孝勇以及共青城芯鑫和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯鑫和”)、共青城芯鑫全投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫全”)、共青城芯鑫龙投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫龙”)、共青城芯鑫成投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫成”)、共青城芯鑫旺投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫旺”)、共青城芯鑫盛投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫盛”)、共青城芯鑫阳投资合伙企业(有限合伙)(“芯鑫阳”)、沈阳盛腾投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛旺投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛全投资管理中心(有限合伙)、沈阳盛龙投资管理中心(有限合伙)合计持有公司股份31,626,068股。其中,芯鑫和、芯鑫全、芯鑫龙、芯鑫成、芯鑫旺、芯鑫盛、芯鑫阳存在股份质押情况,具体如下:

股东名称	持股数量	持股比例	质押股份数量	质押股份数量占公司总股份的比例
芯鑫和	3,024,934	1.09%	2,991,818	1.07%
芯鑫全	3,023,948	1.09%	2,990,839	1.07%
芯鑫龙	3,023,664	1.09%	2,990,560	1.07%

芯鑫成	3,023,200	1.09%	2,990,103	1.07%
芯鑫旺	3,023,159	1.09%	2,990,063	1.07%
芯鑫盛	3,022,150	1.09%	2,989,065	1.07%
芯鑫阳	3,018,210	1.08%	2,985,164	1.07%
合计	21,159,265	7.60%	20,927,612	7.52%

注：上表中总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，为四舍五入所致

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：


刘宪广


张贺



招商证券股份有限公司

2024年9月6日